

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005 年 5 月 19 日 (19.05.2005)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/045946 A1

(51) 国際特許分類<sup>7</sup>: H01L 51/00, 29/786, 29/06, B82B 3/00

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/016574

(22) 国際出願日: 2004 年 11 月 9 日 (09.11.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:  
特願 2003-379729  
2003 年 11 月 10 日 (10.11.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電  
器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUS-  
TRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大  
字門真 1 0 0 6 番地 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 脇田 尚英  
(WAKITA, Naohide).

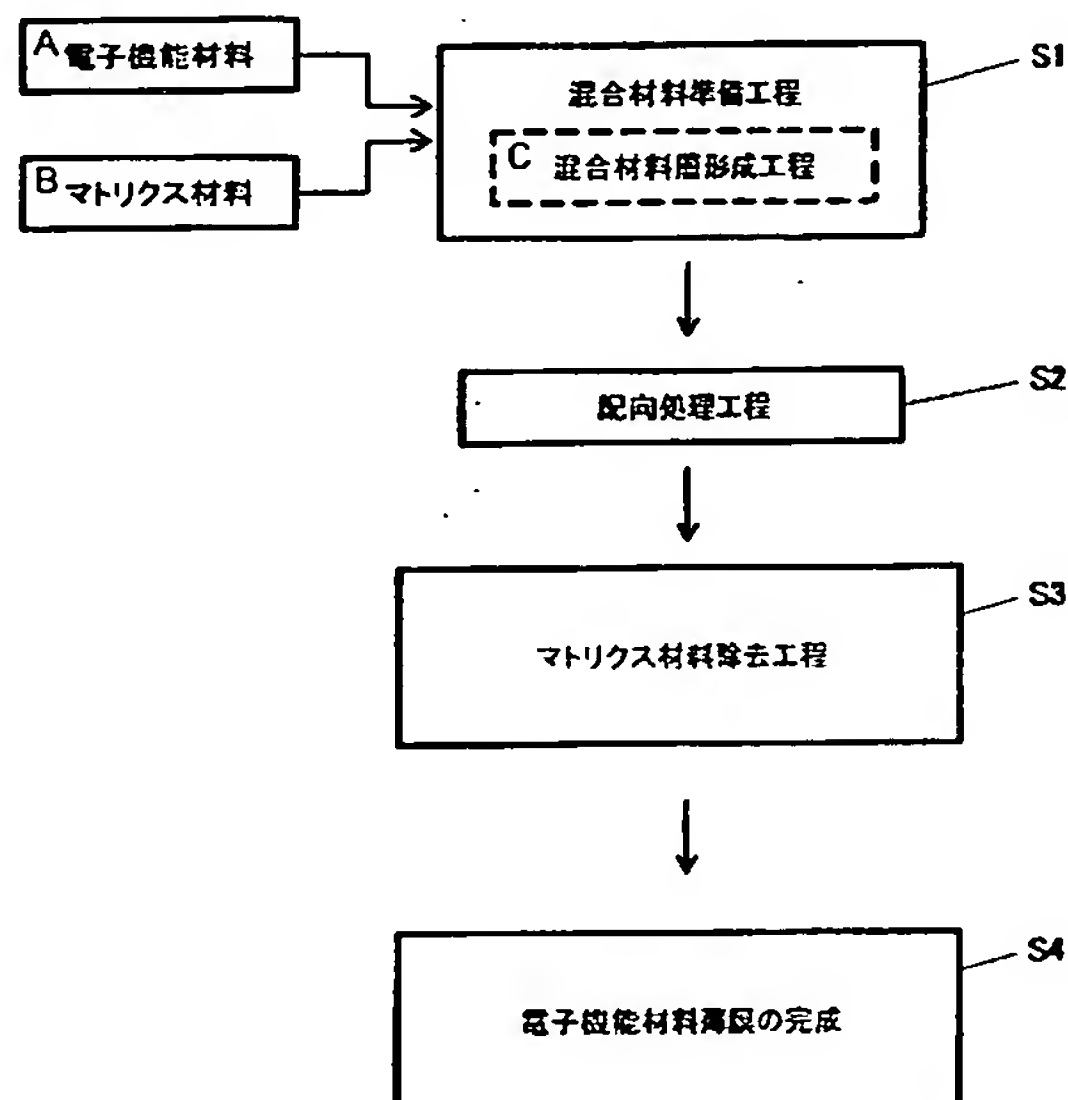
(74) 代理人: 角田 嘉宏, 外 (SUMIDA, Yoshihiro et al.); 〒  
6500031 兵庫県神戸市中央区東町 1 2 3 番地の 1 貿  
易ビル 3 階 有古特許事務所 Hyogo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が  
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,  
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,  
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,  
ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,  
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,  
NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,  
SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,  
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

/続葉有/

(54) Title: METHOD FOR ORIENTATION TREATMENT OF ELECTRONIC FUNCTIONAL MATERIAL AND THIN FILM  
TRANSISTOR

(54) 発明の名称: 電子機能材料の配向処理方法と薄膜トランジスタ



(57) Abstract: A method for the orientation treatment of an  
electronic functional material which comprises a mixed material  
preparation step (step 1) of preparing a mixed material from an  
electronic functional material and a matrix material for orienting  
the electronic functional material, a orientation treatment step  
(step 2) of orienting the mixed material, and a matrix material  
removal step (step 2) of removing the matrix material in the  
mixed material.

(57) 要約: 本発明の電子機能材料の配向処理方法は、電  
子機能材料と前記電子機能材料を配向させるためのマト  
リクス材料との混合材料を準備する混合材料準備工程 (ス  
テップ S1) と、前記混合材料を配向させる配向処理工  
程 (ステップ S2) と、前記配向された前記混合材料の  
中の前記マトリクス材料を除去するマトリクス材料除去  
工程 (ステップ S3) とを有する。

S1... MIXED MATERIAL PREPARATION STEP  
S2... ORIENTATION TREATMENT STEP  
S3... MATRIX MATERIAL REMOVAL STEP  
S4... COMPLETION OF THIN FILM OF ELECTRONIC  
FUNCTIONAL MATERIAL  
A... ELECTRONIC FUNCTIONAL MATERIAL  
B... MATRIX MATERIAL  
C... MIXED MATERIAL LAYER FORMATION STEP

WO 2005/045946 A1



(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書